联络人
投资人关系
+886 3397 5999 ext. 1204
ir@winfoundry.com

稳懋半导体公告 2020 年第四季自结财务报告

2021 年 02 月 03 日

稳懋半导体，全球最大砷化镓晶圆代工服务公司，已于今(3)日公告 2020 年第四季自结财务报告。

2020 年第四季财务概况

- 本季合并营收新台币 68.61 亿元，较前季增加 4%，较去年同期减少 1%
- 本季合并毛利率及营业净利率均较前季减少 8.4 个百分点，合并毛利率及营业净利率分别为 35.0%及 24.3%
- 本季营业净利为新台币 16.64 亿元，较前季减少 22%，较去年同期减少 29%
- 本季税后净利为新台币 12.76 亿元，较前季减少 35%，较去年同期减少 31%；每股盈余为新台币 3.07 元，前季为新台币 4.68 元

2021 年第一季展望

下列对于未来展望的表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。请参阅后附之「免责声明」。

- 第一季营收预计较前一季下滑 low-teens 百分比。
- 第一季毛利率预计约为 mid-thirties 的水平。

免责声明
本数据可能包含对于未来展望的表述。该类表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同于表述内容。除法令要求外，公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。

管理者评论

"2020年在日益严峻的新冠病毒疫情及纷纷扰扰近一年的中美贸易冲突中画下句点，回顾2020年初市场需求透明度始终不高，产业普遍预期全球智能型手机销售量将因疫情的影响年减超过一成，稳懋却在客户需求成长之下，加上产能分配得宜，在这一年内的四季营收起伏始终维持在一成之内。2020年第四季营收达到新台币68.6亿元，虽然较前一季成长4%，但因产品组合的变化及新台币升值的影响，单季毛利率如之前预期的下滑到35%的水平，每股盈余为新台币3.07元。全年营收则年成长19%，创下新台币255.5亿元的历史新高，毛利率也达到41.4%的高点，每股盈余创下新台币15.45元的历史纪录。

面对5G时代的到来，稳懋领先同业早在多年前已开发5G手机Sub-6 GHz PA相关制程，自2019年营收达到Cellular PA一成的比例后，2020年更无畏疫情干扰进一步成长到两成以上。5G基地台及卫星应用方面，更早在十年前着手开发GaN-on-SiC 制程且销售额已连续两年都有超过五成的年成长。另外，3D感测应用于旗舰智能型手机上已正式迈入第四年，2020年得力于新终端应用的发酵也有不错的成长幅度。2021年在5G手机及基础建设的布建率提高下，物联网(IoT)相关应用的成长也是可预期的。在新技术的开发上，稳懋长期持续投资于未来应用及材料如GaN及InP，除了微波通讯之外，还包括光通讯及光感测方面，例如更多在sub-6GHz和毫米波的手机应用上、数据中心(Data Center)或LiDAR应用于汽车驾驶辅助系统等等，超前部属、提早布局以确保市场应用成熟时稳懋不会缺席，这是我们一直能领先同业，成为业界龙头的关键。

在企业永续发展方面，2020年对稳懋来说也是丰硕的一年，除了上半年公布了稳懋连续六届荣获上柜公司治理评鉴企业排名前5%之外，第四季在国际上稳懋首次入选道琼永续指数(DJSI)，与台积电、日月光及联电等半导体龙头企业并列为道琼永续世界指数(DJSI World Index)企业，同时并在国内荣获TCSA「台湾企业永续奖」及2020 SGS CSR Award。在追求营运佳绩的同时又能兼顾公司治理及永续经营，对稳懋来说是最大的激励与肯定。

展望2021年第一季，营收预期将较前一季下滑low-teens百分比，毛利率约为mid-thirties的水平。"

关于稳懋半导体

稳懋半导体成立于 1999 年，位于林口华亚科技园区，是全球首座以六英吋晶圆生产砷化镓微波集成电路(GaAs MMIC)的专业晶圆代工服务公司。稳懋拥有完整的技术团队及最先进的砷化镓微波晶体管及集成电路制造技术及生产设备，客户群除了全球射频集成电路设计公司(RFIC Design Houses)外，并致力吸引与全球整合组件制造(IDM)大厂合作。在制程技术发展方面，稳懋以多元化及领先为原则，期能提供客户最完整的服务。在无线宽带通讯的微波高科技领域中，稳懋目前提供两大类砷化镓晶体管制程技术：异质接面双极性晶体管(HBT)和应变式异质接面高迁移率晶体管(pHEMT)，二者均为最尖端的制程技术。在光通讯及 3D 感测领域中，稳懋更以 MMIC 生产技术为基础，提供光电产品的开发与生产制造。